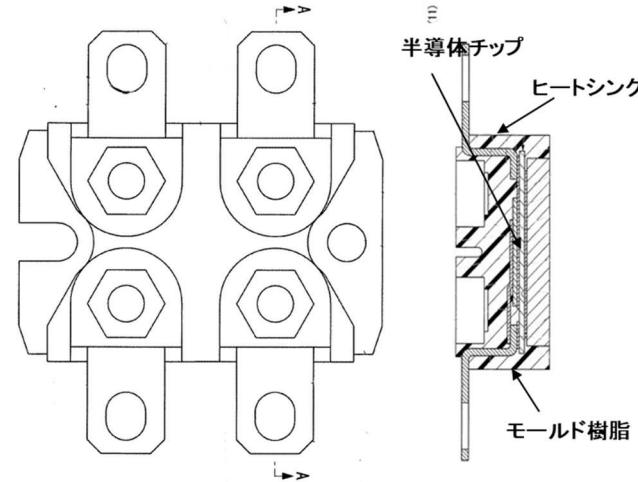


利用シーン(展開可能分野)

ヒートシンクと半導体チップとの間にモールド樹脂を介在させず、さらに、ヒートシンクの一方向の両端部をモールド樹脂から突出させることで、ヒートシンクの容積拡大を図り、放熱性を向上する半導体装置。



発明の効果 (新規性・優位性)

放熱性の向上を重視しながら、ヒートシンクの剥離を防止することができる。さらに、ヒートシンクの一部に応力が集中することも防止可能。

想定するライセンシー像 (保有技術や事業領域)

ヒートシンクを利用したパワー半導体やパワーモジュールの製造販売を検討している企業を想定。